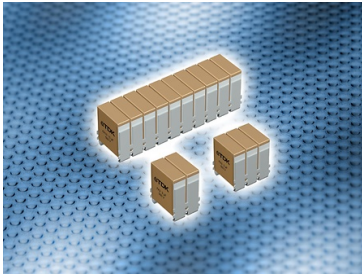


Flexアセンブリ技術を用いたモジュラー方式のCeraLink



TDK株式会社は、Flexアセンブリ技術を用いたモジュラー方式のCeraLink FAタイプの投入により、実績のあるCeraLink コンデンサのラインアップを拡張しました。この省スペース設計により、同じ端子に2個、3個または10個の同一のコンデンサを並列に接続して、容量を増加させることが可能です。

新しいCeraLink FAタイプは、定格電圧500 V DC、700 V DC、および900 V DCが用意されています。定格容量は、電圧およびコンデンサの数によって0.5 μ F~10 μ Fです。これらPLZT（ジルコン酸チタン酸鉛ランタン）セラミックコンデンサの1つの特徴は、150 °Cの高い許容動作温度です。FAタイプは、幅7.4 mm、高さ9.1 mmであり、長さ6.3 mm、9.3 mm、または30.3 mmです。小型サイズにも関わらず、リップル電流耐量は最大47 A_{RMS}です。

並列スイッチングの大きな利点の1つは、0.1~1 MHzの高い周波数で10 m Ω を大幅に下回る非常に低いESR値であることです。ESLの値も、最低3 nHと非常に低いです。CeraLinkコンデンサは、低い寄生効果により、GaNやSiCなど高速スイッチング半導体をベースとするコンバータ・トポロジーに理想的です。スイッチング時の電圧オーバーシュートは、従来のコンデンサ技術よりはるかに低くなっています。また、CeraLinkコンデンサでは、サイズ、電流耐量、および耐熱温度に関わる特殊な要件にも簡単に対応できます。

主なアプリケーション

- 高速スイッチング・コンバータにおけるDCリンクまたはスナバコンデンサ

主な機能および利点

- 定格電圧： 500 V DC~900 V DC
- 容量： 0.5 μ F~10 μ F
- 低い寄生効果
- GaNやSiCなど高速スイッチング半導体をベースとするコンバータ・トポロジーに適切